

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260515

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中欧基金：王鹏、高铮、田佳禾、宋巍巍、凌艺丹、朱瑶琪、邱慧轩，以及吴红德、陈美玲、方志伟、韦瑶瑶、励特特、黄依明、赵兵兵、李晓磊、张雪峰、孟东晖、张菁、许雅淞、康晶晶、徐赛、李海根、朱希民、谢理达、杨越昊、孙秋波、乔世俊、张晨、曹锐钢、王若楠、肖康、齐津、宋焱、张雨溪等其他证券人员，共 35 名投资者
时间	2026 年 5 月 15 日上午 10:00~11:30
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待人员姓名	2026 年 5 月 15 日上午 10:00~11:30：董事会秘书杨平彩女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者问答</p> <p>公司介绍： 公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、锂电业务板块。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。</p> <p>问 1：公司长期重视研发资源投入，请问现阶段在核心技术构建、研发人才梯队建设、知识产权布局层面的整体进展如何，后续将通过哪些举措稳固技术竞争力、维持行业领先水平？</p> <p>答：公司深耕电子功能材料领域，始终以自主技术创新作为核心发展内核，持续加码半导体关键材料、锂电新材料等方向的研发资源投入，现已搭建形成涵盖核心配方研发、精细化合成工艺、规模化量产配套、全流程品质管控等环节的完整自主技术体系。公司组建了专业化、高稳定性的核心研发人才队伍，在材料分子结构设计、纳米级分散制备、高分子聚合改性、精密</p>

制程优化等关键技术领域沉淀深厚，具备扎实的技术攻关与产业化落地能力。依托国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、制造业单项冠军等资质优势，公司围绕 CMP 抛光耗材、高端光刻胶、显示功能材料等主营业务赛道布局多项核心发明专利，构建多层次、全方位的知识产权防护体系，筑牢行业技术壁垒。

面向未来发展，公司将立足产业发展趋势与下游市场实际需求，前瞻性布局前沿材料技术，持续加大全流程半导体材料、新一代电子材料及锂电新材料的研发力度；强化产学研协同创新机制，推进关键技术突破与产业化成果落地；优化完善研发激励与人才引育体系，集聚高端技术研发人才，保障核心技术迭代紧跟行业前沿方向，持续强化公司在国内半导体材料行业的竞争优势与领先地位。

问 2：想了解公司光刻胶产能情况，是否主要针对头部存储厂商的产能扩张需求进行配套布局？

答：公司本次推进光刻胶产能建设，综合考量全球半导体行业发展格局及国内主流晶圆制造企业中长期产能扩张规划，聚焦存储芯片、先进逻辑芯片、先进封装等高增长应用领域，开展前瞻性产能规划与落地。公司潜江二期年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产线于近期刚投产，为国内率先实现从有机合成、高分子合成、精制纯化至光刻胶调配混配全链条自主制备的高端光刻胶生产基地，核心树脂、光酸剂等关键原料实现自主生产，可有效强化供应链自主能力，同时优化产品成本结构。相关产品覆盖多类制程工艺，可满足高端存储芯片、逻辑芯片的制造应用要求。

目前公司高端光刻胶已向国内多家头部晶圆制造企业开展多品类、多批次验证导入，部分规格产品已实现稳定小批量供应，产品综合性能及稳定性获得下游客户充分认可。本次产能扩充，将精准对接下游存储、逻辑类晶圆厂商的高端光刻胶采购需求，加快高端光刻胶产业化落地节奏，持续夯实公司在半导体电子材料领域的平台化布局优势与核心竞争实力。

问 3：本次公司完成业务结构优化调整后，后续整体中长期发展战略、核心产业布局规划以及重点资源投向领域，能否为我们详细介绍？

答：公司本次剥离传统通用打印耗材终端业务，是基于自身发展战略、行业发展周期及长期战略目标作出的重要结构性优化决策。完成本次业务调整后，公司将进一步聚焦核心主业、集中优势资源，坚定落实聚焦半导体关键材料，打造全国一流高端材料综合平台的中长期总体发展战略，全面提升高端材料领域的专业化、精细化、规模化运营水平。

产业布局层面，公司将以半导体 CMP 抛光材料、OLED 显示功能材料、高端晶圆光刻胶三大核心赛道作为主要增长引擎，持续巩固现有优势业务的市场地位，深耕存量市场、挖掘增量空间，不断做强做优半导体及显示材料板块；同时顺应新能源产业发展浪潮，前瞻布局新型锂电功能材料等前沿高景气赛道，培育第二增长曲线，逐步构建起多品类协同互补、高附加值产品引领、抗周期能力更强的现代化业务矩阵，实现向多个赛道的综合材料平台企业升级。在重点投资方向上，公司将持续锚定主业深耕，加大对高端 KrF/ArF 光刻胶、CMP 抛光垫、高端抛光液及配套辅助材料等核心产品的产能扩建、产线升级与工艺迭代投入，夯实产能供给能力；同步向上游关键

原材料领域延伸布局，完善核心树脂、光酸剂、磨料颗粒等关键物料的自研自产与自主配套体系，持续优化成本结构与交付稳定性；市场端将持续深化国内头部晶圆厂、面板厂的深度战略合作，拓展深度绑定的客户生态，同时稳步推进海内外市场布局，提升全球化市场服务与供应能力。

未来，公司将坚守技术自主创新、核心产业自主可控、供应链安全自主保障的核心发展原则，依托技术研发、产能规模、客户资源、平台化布局多重优势，持续推进业务规模化、运营平台化、布局国际化建设，不断提升综合竞争实力与行业话语权，致力于成长为全球半导体及高端电子材料领域具备核心竞争力与重要行业影响力的标杆型材料企业。

问 4：能否介绍一下公司先进封装材料及高端晶圆光刻胶，现阶段订单落地进度与下游客户端验证、导入及放量的最新推进情况？

答：截至目前，高端晶圆光刻胶板块，公司浸没式 ArF、KrF 系列产品研发与产业化进程有序提速，产品可实现国内晶圆制造领域全制程、全尺寸工艺覆盖。产品端已完成超 30 款高端光刻胶的研发储备，其中超 20 款正在下游客户送样验证，12 款以上进入加仑级样品测试环节，整体验证进度符合预期。目前已有 3 款核心型号实现稳定批量供货，同时持续拓展多家头部晶圆制造客户并开展同步验证，客户结构持续优化，商业化落地进程全面提速，产业化前景广阔。公司半导体先进封装材料业务整体发展态势良好，已完成 7 款规格型号的研发布局，现阶段已有几款产品顺利获得多家下游客户订单，在售产品矩阵持续丰富，合作客户覆盖范围不断拓宽，订单增长势能持续释放。临时键合胶产品在现有合作客户实现稳定、规模化供货的基础上，顺利实现新客户开发与订单落地，应用场景持续拓展，市场渗透力逐步提升。

问 5：公司在半导体材料领域的核心竞争壁垒主要体现在哪些方面，如何持续巩固行业领先地位？

答：在半导体材料行业竞争格局下，公司依托长期技术积累、全产业链布局、供应链自主化及平台化产品矩阵，构建了区别于行业同行的多层次核心竞争壁垒。技术层面，公司深耕材料领域多年，搭建了覆盖分子设计、精细合成、纳米分散、精密制程、质量管控的全链条自主研发体系，在 CMP 抛光材料、高端晶圆光刻胶、先进封装材料等赛道实现核心技术自研，拥有完善的专利布局与知识产权保护体系，技术积淀深厚且迭代能力突出；产业链层面，公司率先实现关键上游原材料自主配套，打通“原料—中间体—成品”一体化制备能力，有效规避外部供应链波动风险，同时形成显著的成本与交付优势；产品布局层面，公司实现 CMP 抛光垫、抛光液、高端晶圆光刻胶、封装 PI、临时键合胶等多品类协同发展，具备平台化材料供应能力，可更好匹配下游晶圆厂一站式采购需求；客户层面，公司深度绑定国内头部晶圆制造、封测企业，经过长期验证形成稳定合作关系，客户粘性高、导入壁垒强。

为持续巩固并扩大行业领先优势，公司将坚持技术创新驱动，持续加码前沿半导体材料研发投入，紧跟先进制程迭代方向，强化关键技术攻关与成果转化产业化落地；持续完善上游原材料自主配套体系，进一步夯实供应链安全

	<p>保障能力，优化成本结构；深化与下游核心客户的战略合作，紧跟客户扩产节奏推进产能布局，提升产品批量供货规模；同时完善高端人才引育与激励机制，强化产学研协同创新，依托规模化、平台化、国际化发展路径，持续筑牢技术、产品、供应链及客户壁垒，稳固公司在国内高端材料领域的龙头地位。</p> <p>二、市值管理制度执行情况</p> <p>为持续夯实公司核心投资价值，健全完善市值管理体系，切实保障公司、广大投资者及相关方合法权益，严格恪守监管合规要求，结合公司经营发展实际，公司于 2025 年 4 月 制定《市值管理制度》，为常态化、规范化开展市值管理工作提供坚实制度保障。</p> <p>公司严格遵照已制定的《市值管理制度》，结合公司半导体材料、锂电辅材等核心业务发展实际，持续规范落实各项市值管理及投资者关系管理工作。报告期内，公司依托制度指引，主动加强与机构投资者、券商研究机构等资本市场主体的常态化沟通交流，积极接待各类调研走访，全面、客观传递公司在半导体材料、新能源材料等领域的业务布局、研发进展、产能建设及中长期发展战略，及时回应市场对公司核心主业、行业趋势及经营规划的重点关切。公司严格遵守信息披露相关法律法规及监管规则，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，统筹做好投资者沟通、舆情管理、价值传播等工作，切实维护公司整体形象及全体股东、投资者的合法权益，通过规范有序的市值管理举措，持续夯实公司内在价值，提升资本市场认可度，推动公司长期价值稳健增长。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 15 日